

# 2025年3月期 第3四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614  
2025年2月13日

## 売上高および各利益とも低調で減収・減益

- 当第3四半期の売上高は、電子システム事業の売上の落ち込みが大きく、通期予想比及び前年同期比ともに低調な結果となる。マイクロエレクトロニクス事業は堅調に推移、製品開発事業は前年同期比僅かながら減収。
- 利益は、減収による影響に加え、人員増及びベースアップによる労務費増加や新基幹システム稼働による償却費発生、前年同期では発生がなかった福島事業所の経費発生等によりコストが大きく増加し、営業利益・経常利益ともに前年同期比大幅減益、通期修正予想に対する進捗も低調な実績にとどまる。

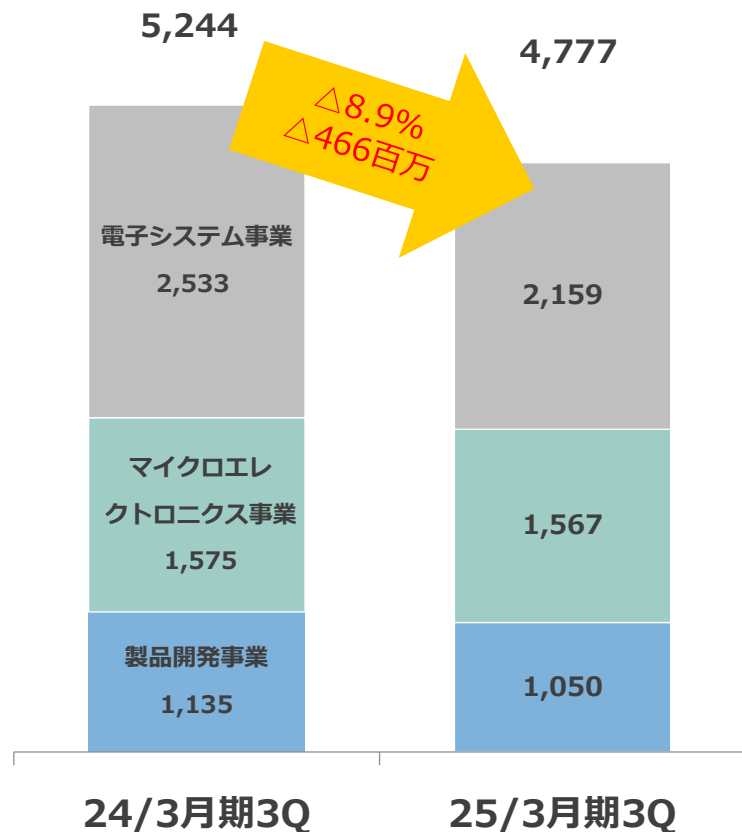
(単位：百万円、%)

|       | 2025/3期<br>修正予想 |      | 2025/3期<br>3Q実績<br>(累計) |      | 通期予想比 | 前年同期比 |      |
|-------|-----------------|------|-------------------------|------|-------|-------|------|
|       | 金額              | 構成比  | 金額                      | 構成比  | 進捗率   | 増減率   | 増減額  |
| 売上高   | 6,715           | 100  | 4,777                   | 100  | 71.1  | △8.9  | △466 |
| 販管費   | 1,276           | 19.0 | 935                     | 19.6 | 73.3  | 1.6   | 14   |
| 営業利益  | 155             | 2.3  | △6                      | △0.1 | —     | —     | △519 |
| 営業利益率 | 2.3             |      | △0.1                    |      |       |       |      |
| 経常利益  | 150             | 2.2  | △11                     | △0.2 | —     | —     | △530 |
| 当期純利益 | 130             | 1.9  | △10                     | △0.2 | —     | —     | △367 |

3Qにおいても車載用半導体の市場在庫充足による生産調整局面が継続する中、バーンインボードを中心とする半導体後工程商材の受注が大きく落ち込み、電子システム事業が大幅減収。マイクロエレクトロニクス事業は堅調に推移、製品開発事業は前期同期比僅かながら減収。

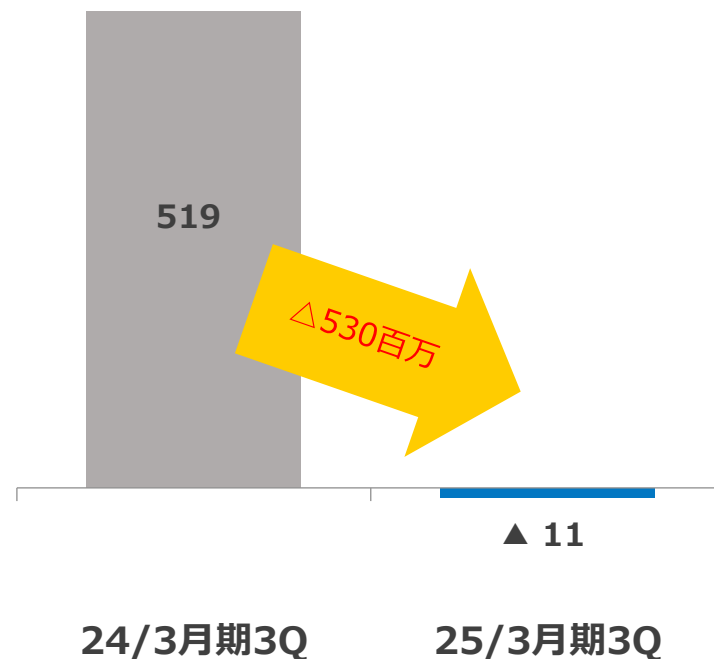
## 【売上高】

（単位：百万円）



## 【経常利益】

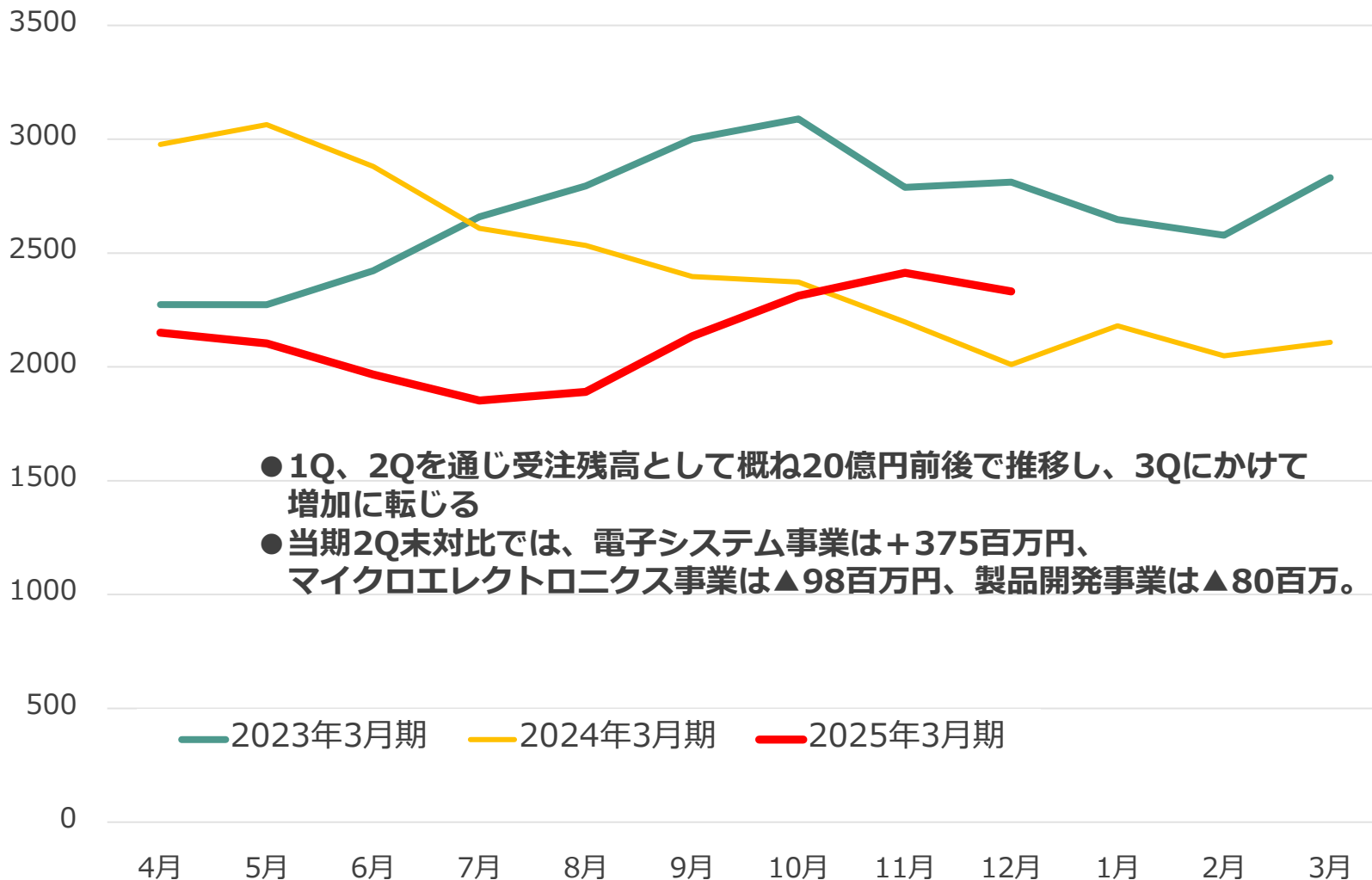
（単位：百万円）



※売上高・経常利益とも前期同期比で減収減益。

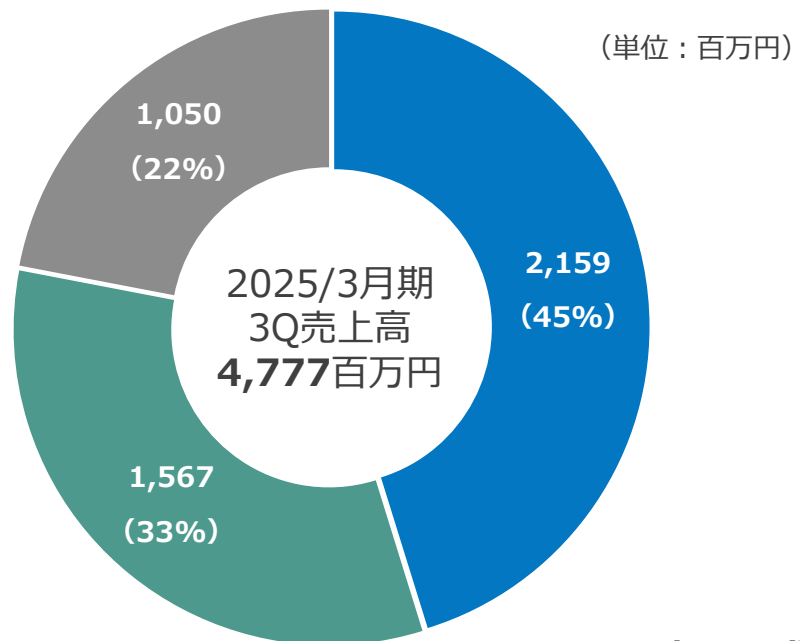
## 【受注残高（全社）】

(単位：百万円)

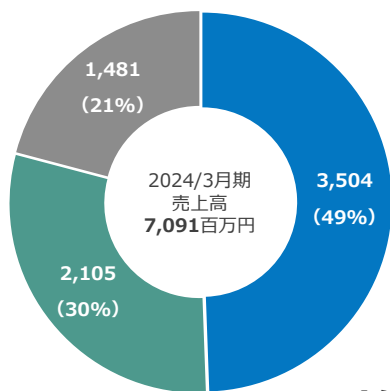


- 1Q、2Qを通じ受注残高として概ね20億円前後で推移し、3Qにかけて増加に転じる
- 当期2Q末対比では、電子システム事業は+375百万円、マイクロエレクトロニクス事業は▲98百万円、製品開発事業は▲80百万。

— 2023年3月期    — 2024年3月期    — 2025年3月期



25/3月期3Q売上構成



(参考) 24/3月期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

## 製品開発事業

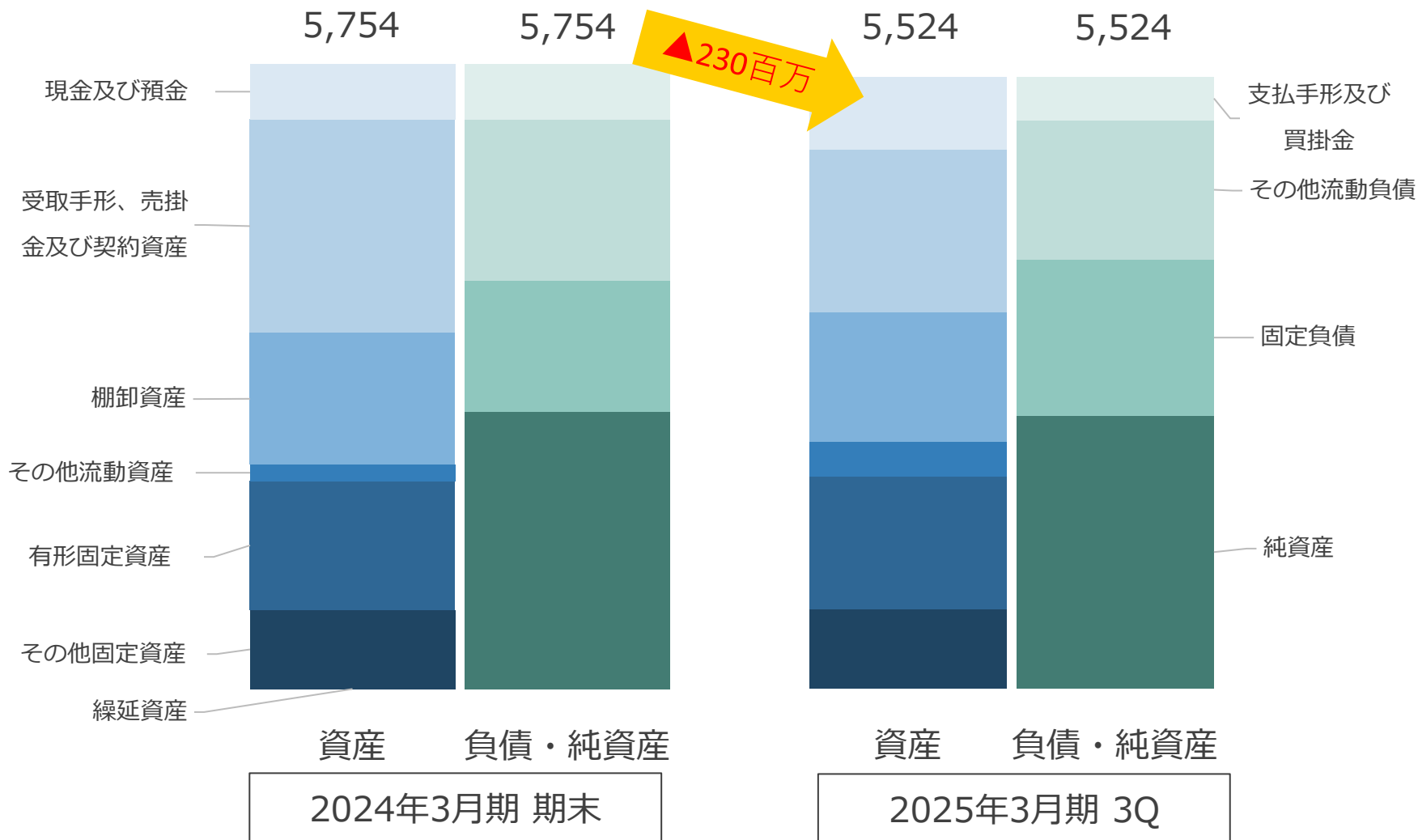
### 製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

【流動資産】 現預金148百万円増加、売上債権343百万円減少。

【流動負債】 仕入債務122百万円、未払法人税等118百万円、賞与引当金129百万円、各々減少。

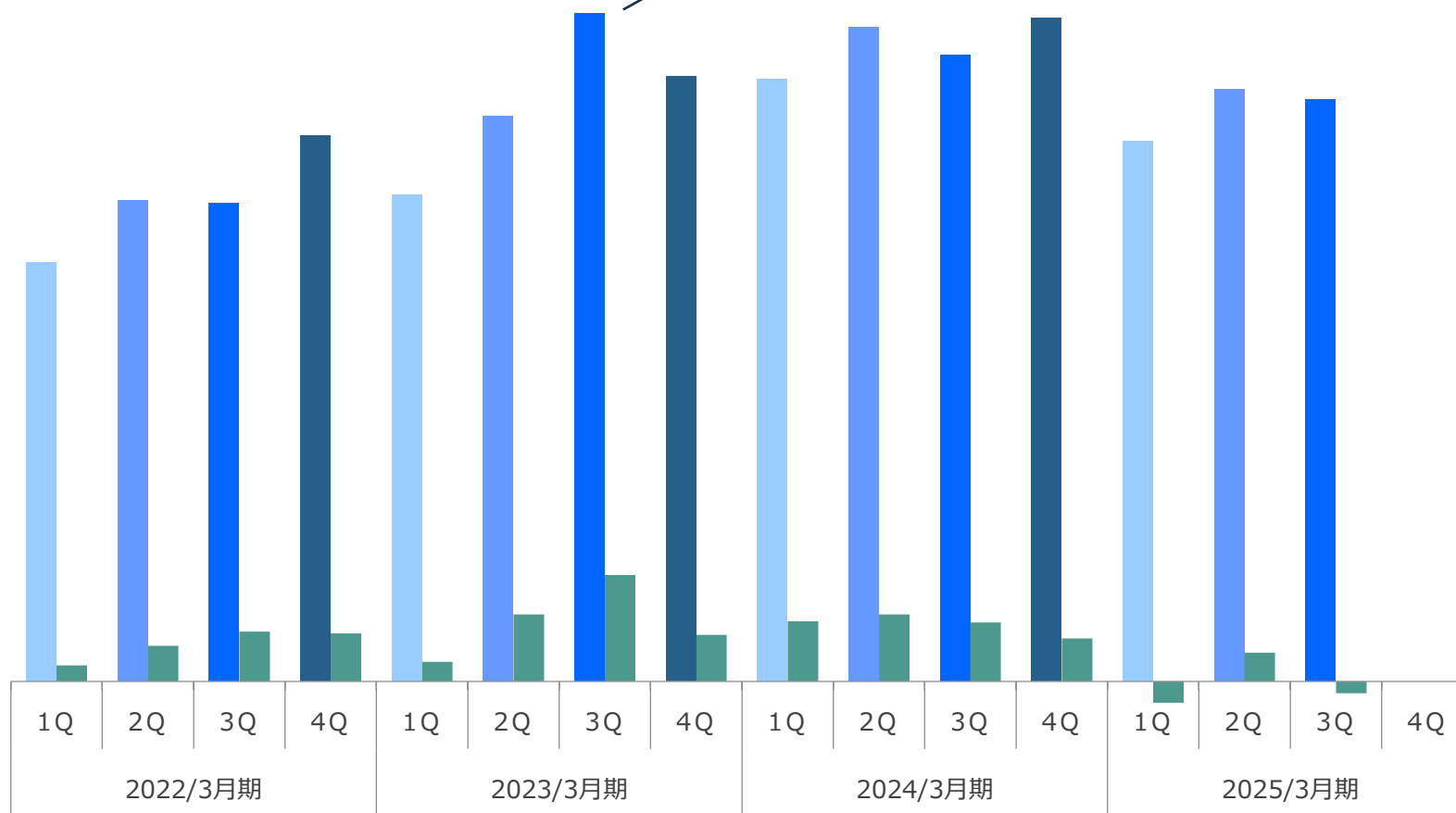
【純資産】 利益剰余金減少により純資産83百万円減少。自己資本比率44.6% (+0.3pt)。



|       |        |   |    |
|-------|--------|---|----|
| 2024年 | 4月 12日 | 当社技術に関する記事掲載<br>(無人探査機「SLIM (スリム)」に、当社画像処理技術が搭載)                      | 1Q |
|       | 5月 14日 | 決算発表<br>剰余金の配当  |    |
|       | 5月 29日 | 太陽光発電による再生可能エネルギー (オフサイトPPA)の採用                                       |    |
|       | 6月 12日 | 決算説明会<br>神奈川県横浜市中区に神奈川事業所を設置・事業開始                                     |    |
|       | 6月 19日 | ルネサスエレクトロニクスのプリファード・パートナーに参画  |    |
|       | 6月 25日 | 第52期 定時株主総会<br>とやま介護テクノロジー普及・推進センターにて、センサー+カメラ一体型見守りシステム「C-エイド」常設展示開始 |    |
|       | 7月29日  | ルネサスIPライセンスパートナーに加入   |    |
| 2024年 | 8月23日  | 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 様より感謝状を受領   | 2Q |
|       | 8月28日  | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社様より「Contribution Award」を受賞                      |    |
|       | 8月29日  | 個人投資家向け会社説明会  |    |
| 2024年 | 10月16日 | くまもと3D連携コンソーシアムに入会のお知らせ   | 3Q |
|       | 11月6日  | 半導体検査装置の海外向け製品の販売を開始  |    |
|       | 12月6日  | 上期決算説明会   |    |

■ 1Q売上高   
 ■ 2Q売上高   
 ■ 3Q売上高   
 ■ 4Q売上高  
■ 経常利益

マイナンバーカード推進に伴う  
カメラ応用機器が特需的に増加

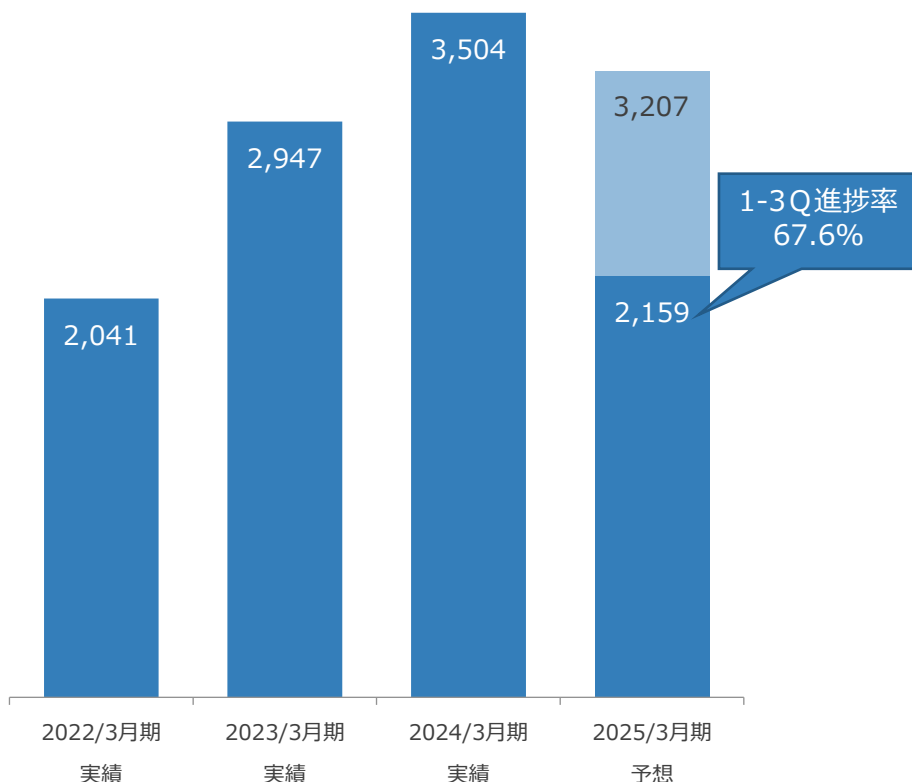




車載半導体は市場在庫過多による各社生産調整が継続、顧客の試験方法変更等も重なりボード需要急減。  
 パワー半導体・センサー向けのカスタムバーンイン装置は、前年の生産設備拡充完了により所要減。  
 車載用専用計測機器は前年から増加も周辺機器減少及び発注時期後ろ倒しで微増にとどまる。

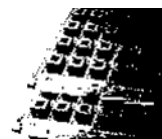
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 3Qトピックス

▶ 半導体装置検査装置の受注がけん引



**バーンインボード**  
 前年同期比：64%



**半導体検査装置販売・リース**  
 前年同期比：23%



**車載製品用専用計測機器関連**  
 前年同期比：104%

**Edge Tech2024+ 出展**  
 Nessim出展 11月



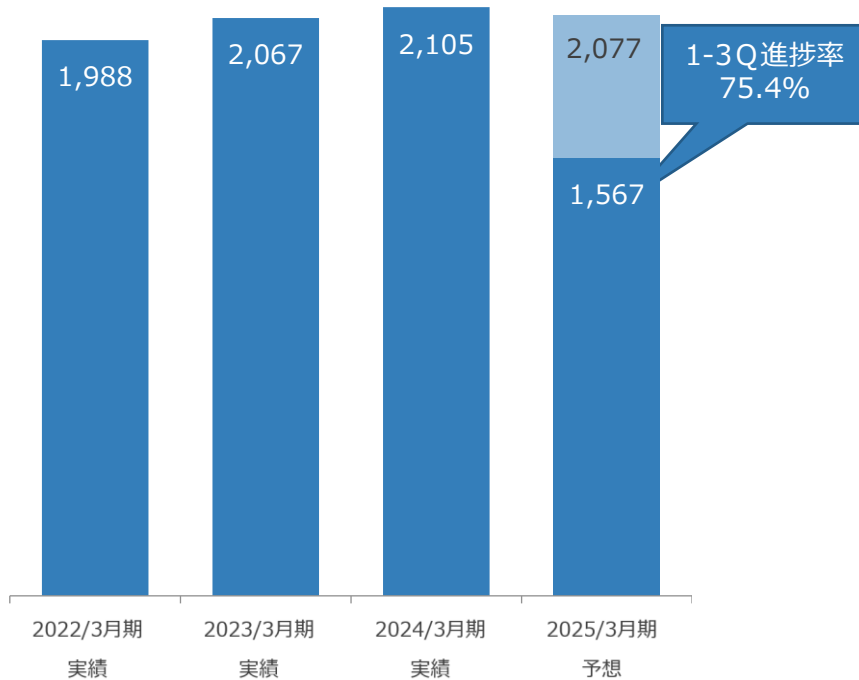
**各社プライベート展示会 出展**  
 複数社のプライベート展示会に  
 電子システム商材を出展



アナログは自動車向けパワー半導体設計が前年より増加。モバイル向けセンサー用半導体の受注は堅調も産業計測分野向けで前年から減少。デジタルは自動車向け設計に注力も減少。

## 【売上高】

(単位：百万円)



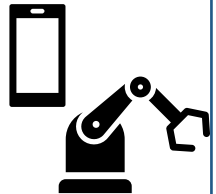
## 3Qトピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体  
前年同期比：139%



センサー用半導体  
前年同期比：74%



### ➤ デジタル半導体設計受託

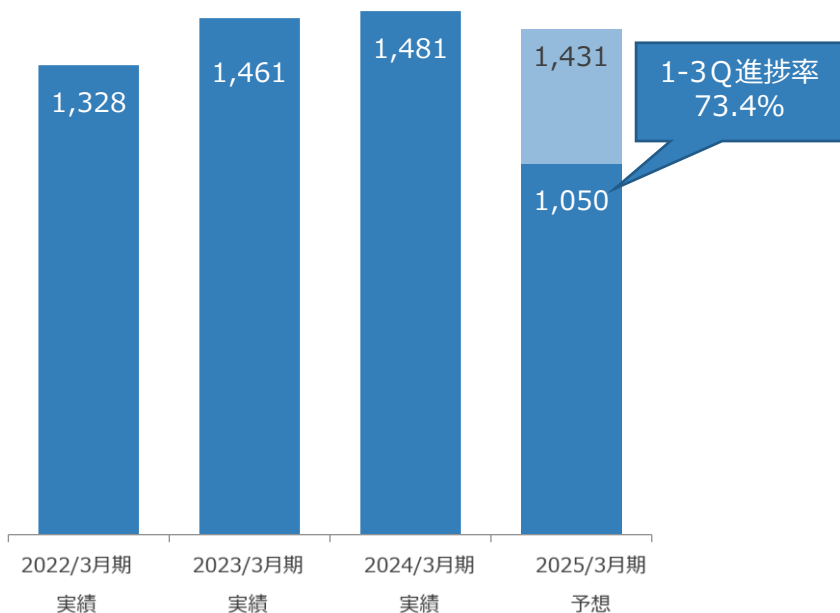
自動車関連デジタル設計  
前年同期比：90%



ATM、POS、受付端末など端末機器向けビューカメラの需要が減少。  
 医療検体検査、カードゲーム、産業用ドローンなどの画像センシングカメラは好調。

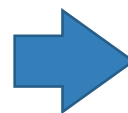
## 【売上高】

（単位：百万円）



## 3Qトピックス

- 製品種では画像センシングカメラが牽引



ビューカメラ  
前年同期比:87%



画像センシングカメラ  
前年同期比:182%

- 独Electronicaで AIカメラソリューションを展示



- 新製品 3 種の先行販売を開始

- ・エッジAI画像処理120万画素インテリジェントカメラ
- ・200万画素 小型シンプルLANカメラ
- ・150万画素MIPI出力カメラ



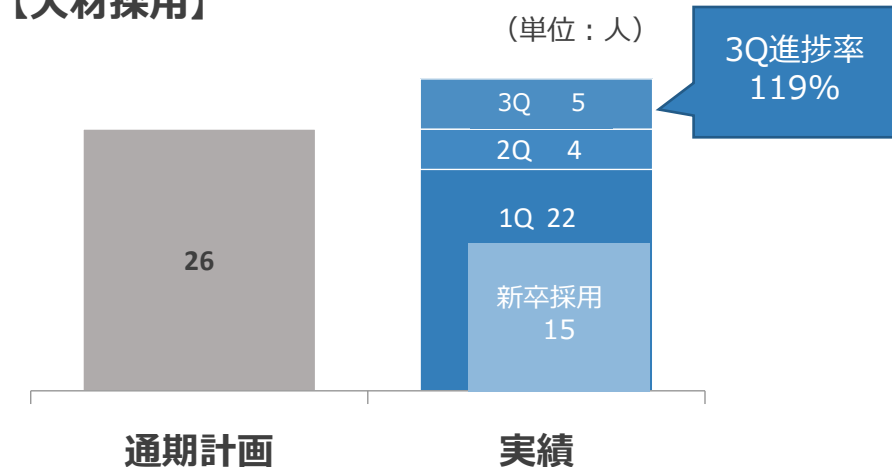
国際画像機器展、EdgeTECHにサンプルを出展

- 見守りシステム市場導入に向け 第三種医療機器製造販売業務許可を取得（一般医療機器クラス I）

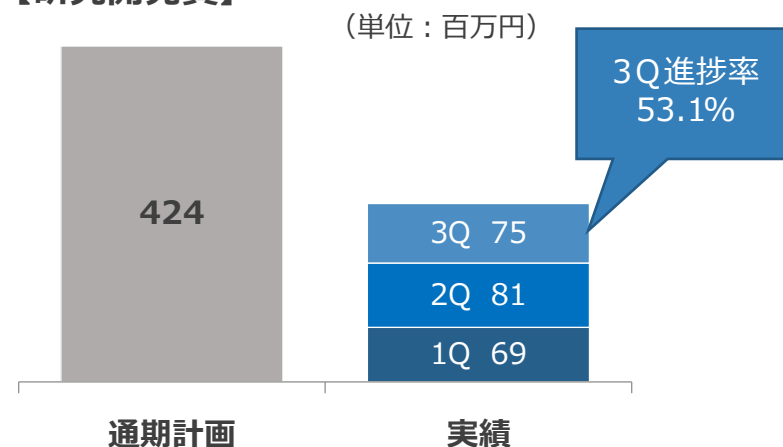


人材採用の進捗率としては計画を超えて堅調に推移するも、人材争奪戦は継続。  
 研究開発費は直近の販売に結び付く重要テーマに絞った計画見直しにより進捗率未達。

## 【人材採用】



## 【研究開発費】



## 主要開発テーマ

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・次世代IoT-PLC通信モジュール

### マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア・アナログIP

### 製品開発事業

- ・カメラモジュールラインナップ増強
- ・次世代エッジAIカメラシステム開発・介護向けシステム製品化開発

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## ご注意事項

### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

## お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

取締役管理本部長 舩田 敏彰

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/